

第 17 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 29 年 5 月 22 日(月) 10:30~16:20

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室 (東京都中央区)

時間	題 目	講 演 者
10:30~ 12:00	司会 鎌田 信雄 (化研テック(株))	
	『無加圧接合用焼結Cuダイボンド材料』 (45 分)	○江尻 芳則(日立化成(株))
	『ナノ/サブミクロン複合粒子を用いた 無加圧低温接合』 (45 分)	○増山 弘太郎、山口 朋彦、 樋上 晃裕、山崎 和彦 (三菱マテリアル(株))
12:00~ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00~ 13:10	委 員 会 議 事	
13:10~ 14:30	司会 岩田 剛治 (大阪大学)	
	Mate2017 受賞講演 『酸化銅ペーストを用いた接合における 酸化銅還元過程が接合性に及ぼす影響』 (35 分)	○八尾 崇史、松田 朋己、石井 克典、 佐野 智一、廣瀬 明夫(大阪大学)、 森川千晶、大淵 敦司、屋代 恒 ((株)リガク)
	Mate2017 受賞講演 『材料非線形を考慮したパワーモジュール用 ワイヤボンディングの熱疲労信頼性評価』 (45 分)	○宍戸 信之*1*2、葉山 裕*1、 宮崎 則幸*1*2 *1北九州市環境エレクトロニクス研究所、 *2九州工業大学
14:30~ 14:40	休 憩	
14:40~ 16:10	司会 山部 光治 ((株)東芝)	
	『In 添加はんだの信頼性試験における 耐久性とクラック挙動』 (45 分)	○和田 剛優、森 公章、白井 武史 ((株)弘輝)
	『Au添加によるSn基はんだ合金の 高強度化について』 (45分)	○濱田 真行(大阪産業技術研究所)、 森 雄基、上杉 徳照、瀧川 順庸、 東 健司(大阪府立大学)
16:10~ 16:20	表 彰 式	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。